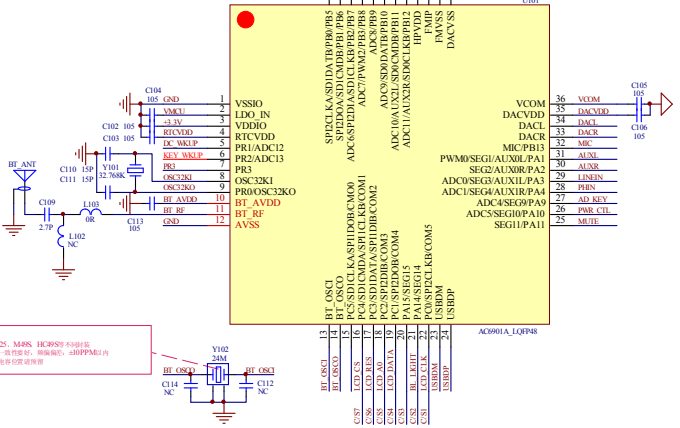


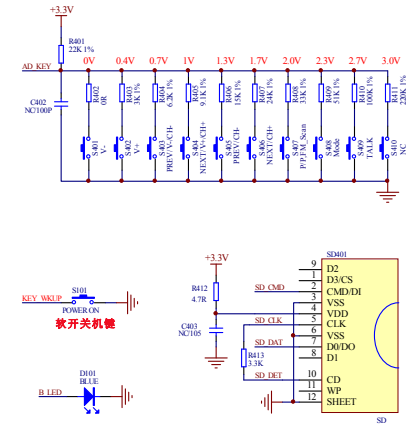
注：原理图中注释说明设计时需特别注意

- 设计注意事项：
1. 软开关机方案时，主控LDOIN不断电接VBAT，+3.3V可以通过软件关断。
  2. RTCVDD为内部RTC供电电源，休眠模式下不断电，此脚必须接100nF电容。
  3. PR1、PR2、PR3为唤醒IO，高低电平都可以唤醒。按键开关机唤醒请使用PR2口低电平唤醒，因PR2口接有复位功能(低电平复位有效)，可解决特殊情况死机不开机问题。
  4. 本方案只是普通软件关机，不兼容RTC芯片，32K晶振可以省略。
  5. 主控所有电源的退耦电容必须靠近芯片放置，退耦电容的回路电阻必须最短回到该电源地。
  6. 主机电源不断电，最低待机功耗400uA以下。对于有更低待机功耗要求的客户，请使用NMOS管开关机电路，电路请参考附件。
  7. FMVSS不分地，需接天线GND。
  8. 对FM要求比较高的客户，请预留FMIC电路，FMIC电路请参考附件。FM匹配电路和放大电路磁芯数字地，必须保证磁芯的完整性，FM信号线圈地间距至少0.6MM以上。
  9. FMIC天线必须接AC9000系列FMPCB Layout设计。
  10. 为保证产品的安全可靠性，电池必须使用带保护板的电池。

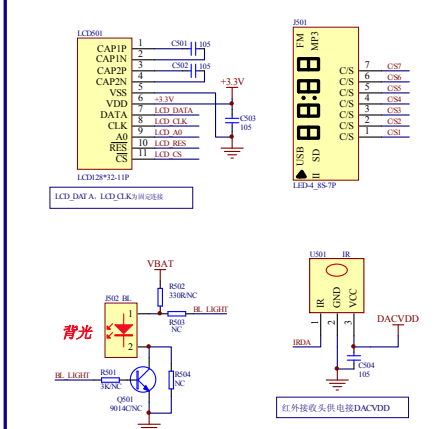


晶振电路  
原理：单晶振电路，AMP、ICPSPY 0.01uF  
注意：晶振电路一般接在MCU的晶振引脚，晶振电路的GND必须接在MCU的GND引脚，晶振电路的VCC必须接在MCU的VCC引脚。

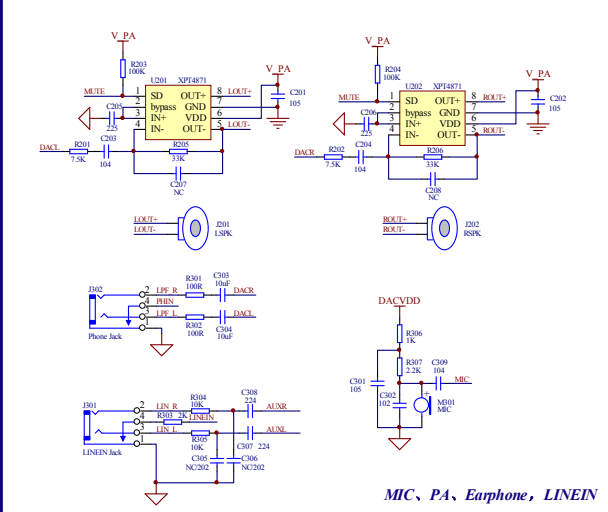
MCU



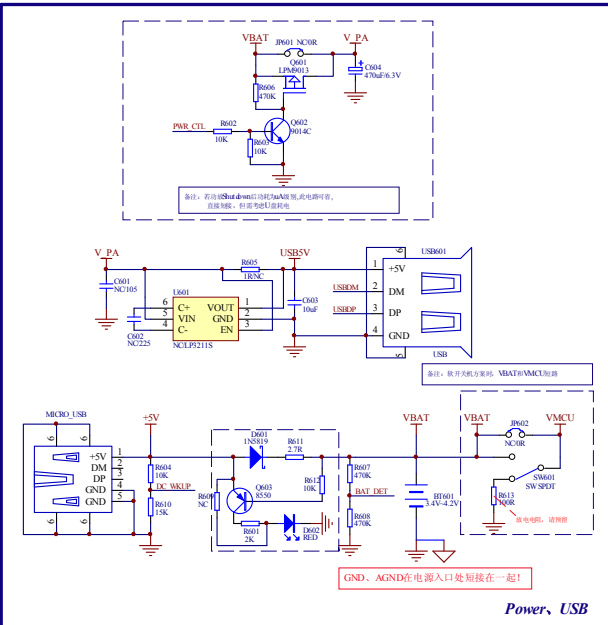
KEY、SD



LED、LCD、IR



MIC、PA、Earphone、LINEIN



Power、USB